

「Interop Tokyo 2026」出展のご案内

拝啓 陽春の候、貴社益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、「Interop Tokyo 2026」に出展の運びとなりました。
内容を下記のとおりご案内いたしますので、ご来場下さいませよう何卒宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

<記>

幕張メッセ 展示ホール8 小間番号:8F25
日時6月10日(水)・11日(木)・12日(金) AM10:00～PM6:00
(12日[金]のみPM5:00まで)

主な見所

高負荷サーバー搭載を想定したデータセンター向けの最適なソリューションとして、新型サーバーラック「AIRシリーズ」を出展いたします。

開口率 84.3% のハニカムパンチングメタルを採用した前後ドアは、従来ラックを大きく上回る排熱性能を発揮。高負荷GPUサーバーの安定稼働に貢献します。

高密度サーバーに必須となる高重量機器の実装に対応し、最大1tの搭載荷重を確保したフレーム構造を採用。耐震性能の試験にも合格しており、データセンターの求める環境に安心して導入できます。

また、AIRラックの背面ドアには、高負荷サーバー向けの冷却効率と省スペース性を両立する「Active Rear Door Heat Exchangers (ADHxシリーズ)」を搭載。AIRラックに追加加工無しで取付を実現いたします。

そして、AIRラックが水冷サーバーシステムに進化致します。背面拡張フレーム・水冷サーバー・CDU・マニホールド・システム構成・施工まで私たちのアライアンスでトータルコーディネートをご提案致します。

実運用を想定した展示により、導入後のイメージを具体的にご確認いただけます。

さらに、特許取得済みの排熱効率化ソリューション「モジュール式空調アシストシステム」や、「トップヒートシャッター (Top Heat Shutter)」を取付致します。ラック背面からの排熱が前面へ回り込むことを防ぎ、マシンルーム全体の空調効率を飛躍的に高める空調補助ソリューションです。

そのほかにも、樹脂製ブランクパネル「EZIブランク」シリーズを出展いたします。

「EZIブランク」は、19インチラックの未使用スペースを効率的に塞ぎ、ホットアイルとコールドアイルの空気混在を防止することで、機器の冷却効率を大幅に向上させるソリューションです。

ツールレスで簡単に取り付けられ、1Uごとに切り離し可能な柔軟な設計により、機器実装に合わせた使いやすさを実現しています。

また、ブラック・ホワイトのカラー展開や、ケーブル通線がスムーズに行えるブラシ付き「EZI BRUSH」モデルなど、用途に応じたラインアップも充実。軽量かつ耐久性の高い樹脂素材を採用し、排熱対策と作業性の両立を追求しています。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

来場事前登録はこちらのサイトからお願いします。 <https://www.interop.jp/>

<主な出展製品>

”新型サーバーラック”	・AIRラックシリーズ	好評発売中
”水冷サーバーシステムのご案内” (ラック背面拡張フレーム・水冷サーバー・CDU・マニホールド・システム構成・施工)	”水冷サーバーソリューション”	初出展
”高負荷ラック冷却ソリューション”	・ADHxシリーズ	好評発売中
”排熱効率化ソリューション”	・モジュール式空調アシストシステム	好評発売中
”空調効率化天井パーテーション”	・トップヒートシャッター	好評発売中
”樹脂製ブランク/ブラシパネル”	・EZIブランク/EZI BRUSH	好評発売中

小間番号:8F25

ニッキャビ 株式会社